

钼铜电子封装片金属注射成型工艺

产品名称	钼铜电子封装片金属注射成型工艺
公司名称	秦皇岛中为精密机件有限公司
价格	1.00/件
规格参数	中为精密:半导体 钼铜合金:金属注射成型工艺 秦皇岛:订制
公司地址	昌黎县荒佃庄镇荒佃庄村北（注册地址）
联系电话	18630349507

产品详情

钼铜合金电子封装片的介绍

秦皇岛中为精密机件有限公司生产的金属注射成型钼铜合金电子封装片MIM零部件

产品名称	材质	生产工艺	烧结温度	模具	订制
钼铜合金电子封装片	钼铜合金	金属注射成型	1500	需订制	是
化学成分	合号CuMo杂质元素总量MoCu1010+/-2余量 0.1MoCu1515+/-3余量 0.1MoCu2020+/-3余量 0.1MoCu2525+/-3余量 0.1MoCu4040+/-5余量 0.1				
可用材料	低碳不锈钢，钛合金（Ti、TC4），铜合金，钨合金，硬质合金，高温合金(718、713)				

钼铜合金电子封装片的生产工艺

据钼铜废料回收专家——优废了解，钼铜材料的制取基本上与钨铜材料相似，主要通过两种途径：渗铜法和混合物烧结法。

2.1 渗铜法

它是将钼粉直接压制成形，在高温氩气中烧结成多孔钼坯，然后将烧结好的多孔钼坯在真空或惰性气体

下渗入融熔的铜。为了得到所需铜含量的钼铜材料，需要控制烧结钼坯的孔隙度，使这些孔隙渗入铜后达到所要求的铜含量。此法很容易制得含铜 30%(质量分数)的钼铜材料，对于 30%(质量分数)含铜的钼铜材料，则可采用混合部分铜粉的钼铜混合粉进行压制、烧结然后渗铜的方法。

2.2 混合粉烧结法

它是按所需成分的钼铜材料混合钼粉和铜粉，然后压制成形，烧结直接制成产品。也可用氧化钼和氧化铜的混合粉共还原得到钼铜混合粉进行压制烧结，而且后者可以得到组织更为致密更为均匀的产品。高铜含量的钼铜材料更适合用混合粉烧结，因为它工艺简单而同样可得到高致密的产品，必要时还可进一步采用复压来提高密度。低铜含量的钼铜材料直接混粉烧结时，则需首先将钼铜混合粉制成超细粉或进行机械活化，从而提高其烧结活性，保证烧结产品的致密。

二、钼铜合金的应用

根据前述钼铜材料的特性并国内外发展情况，钼铜材料已在以下几个方面获得应用。

3.1 真空开关电触头

目前，国外已将钼铜材料与钨铜材料同时列为电触头材料。国内钨铜真空触头正在大面积推广，但也有个别已选用钼铜材料。因此，可以根据真空开关的不同性能要求，在不同的情况下分别采用钨铜材料和钼铜材料，以达到材料佳的使用效果。

3.2 电真空器散热元件

大功率的集成电路和微波器件要求高电导热导材料作为导电散热元件，同时又要兼顾真空性能、耐热性能及热膨胀系数等。钨铜和钼铜材料由于其各项特性符合这些要求，因此是这方面应用的优选材料。

3.3 仪器仪表元件材料

由于钼铜材料的许多物理特性、如无磁性、定热膨胀系数、高弹性模量、高电导热导性等，使它适合作为一些特殊要求的仪表元件，而且钼铜较钨铜密度低、重量轻、塑性好、机加工方便，更适合于作为仪表材料。

3.4 航天及武器用材

钼铜材料比钼更耐烧蚀，更具有塑性和可加工性，因此，可以用作使用温度稍低的火箭、导弹的高温部件，也可代替钼作为其它武器中的零部件，如增程炮等。

优废大量回收钼铜废料，欢迎有钼铜废料需要处理的企业来电咨询！